



Borland 和 Capgemini 建立战略联盟

美国 Borland 软件公司与 Capgemini 公司近期宣布建立战略联盟, 双方将整合两家公司在应用软件周期管理、企业资源规划及以服务为中心的平台等方面的专业资源, 在共同的销售计划和实时市场策略等方面展开合作。同时, Borland 的解决方案还将在多个 Capgemini 解决方案中心展出, 一方面为双方共有客户提供服务, 另一方面为全球系统集成商的销售代表提供重要的培训设备。
www.borland.com.

Sharp 在中国扩大对 MCU 和 SoC 的技术和客户支持

夏普微电子 (Sharp) 公司近期为中国客户扩大了 MCU 和 SoC 产品的技术和客户支持。通过与 Beijing Creator 的合作, Sharp 现在可提供一种低成本评估板, 从而允许开发者即刻开始对 Sharp 32 位 ARM922T LH7A404 产品进行应用开发和功能评估。除此之外, 新提供的支持还包括经拓展的中文技术文档和其他基于中国市场的销售和业务开发团队。这些支持将使中国工程师能够降低消费电子、多媒体、工业/医药以及汽车应用的开发成本并缩短上市时间。
www.sharpsma.com

JTAG 科技公司支持 NAND 闪存产品

JTAG 科技公司将其 ISP 支持扩展到了基于 NAND 的闪存产品。基于 NAND 的闪存由于具有低功耗、大容量, 而被大量的用在数码相机、3G 终端和 PDA 等便携式设备中。通过应用 JTAG 公司的 BFM 和标准 FDS 软件, 即使在电路板装载完成后, NAND 的可编程性仍能在系统内实现。因此, 那些使用 NAND 设备的设计者和测试工程师将能够运行多种重要的板级应用。
www.jtag.com.

道康宁力推半导体材料发展新模式

美国道康宁公司近期发表了“改变材料发展业务模式”的主题演讲。该公司认为如果从材料发展的早期阶段开始, 材料供应商就组成合作伙伴共同进行新材料研发工作, 则可以达到有效降低风险、加快材料革新步伐的目的, 同时也有助于产业链内形成健康发展的材料供应商。该公司呼吁加强产业内部合作, 探索发展新业务的新模式。据悉, 道康宁公司认为中国在 2-3 年内将成为其全球第二重要的市场。
www.dowcorning.com

益登科技与 Magnolia Broadband 携手中国市场

益登科技宣布, 已和 Magnolia Broadband 公司达成一项代理协

议, 由益登科技在中国台湾地区和大陆市场销售与代理该公司的各种手机芯片组, 同时为采用这些产品的 OEM 厂商提供支持服务。将 Magnolia 的 DiversityPlus 芯片用于双天线手机, 无线通讯业者就能以同样的无线基础设施支持两倍的用户, 而不必增加基站等设施, 同时还加强了手机的覆盖范围、资料速率和电池寿命。Magnolia 正全力推动 DiversityPlus 技术的商业应用, 与益登科技的合作将进一步促成这项策略性计划。
www.edom.com

3G 世界峰会暨展览会 2005 将在港举行

“3G 世界峰会暨展览会 2005” 将于今年 11 月 14-18 日在香港举行。该峰会一直以 ITU IMT-2000/3G 技术为重点, 内容涵盖电讯基建、移动电话、半导体、组件及相关系统服务等, 致力于全面推动未来宽频无线通讯技术的发展, 得到了 CDMA 开发小组、TD-SCMA 论坛等电讯技术组织以及 3GPP、3GPP2、IPv6 论坛等国际性及地区性机构的鼎力支持。同时, 今年还计划设立名为 Networking Area 和 WiMAX Village 的特别展区, 以求为广大业界人士提供更优越的服务。

罗克韦尔推出智能马达控制器新方案

罗克韦尔自动化公司推出的新一代智能马达控制器全面解决方案, 通过采用开放的 Logix 控制平台, 使系统集成更加方便, 且减少了盘柜设计和系统所需的空间。同时, 通过采用 DeviceLogix 大大提高了系统的稳定性, 实现了本地控制功能。此外, 其内置的状态监视和预报警功能还能缩短设备停机和维修时间, 而丰富的统计信息则可对加工过程进行进一步优化, 从而为新一代智能化马达控制提供了一个理想的解决方案。

ARC 授权英飞凌 ARC700 可配置核用于有线接入

ARC 公司宣布, 英飞凌公司已经取得了采用 ARCXY 先进 DSP 技术的 ARC700 可配置处理器核授权, 以用于其下一代有线接入产品。ARC 700 核系列采用 0.13μm 工艺技术, 和最佳化的 7 层管设计, 可以提供高达 405MHz 的时钟频率。同时, 该处理器核还具有一个高性能架构, 该架构可以提供 16 位和 32 位的指令集、众多的流水线和优化的开发工具。英飞凌将利用该高性能核在单个芯片上, 同时执行主机功能和应用处理。从而可大幅度降低系统的设计复杂性和芯片成本。
www.ARC.com